

证券代码：603061

证券简称：金海通

公告编号：2025-037

天津金海通半导体设备股份有限公司

2025 年半年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本期业绩预告适用于“实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以上”的情形。
- 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 7,000 万元到 8,400 万元，与上年同期相比，将增加 3,032.32 万元到 4,432.32 万元，同比增加 76.43%到 111.71%。
- 预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 6,700 万元到 8,000 万元，与上年同期相比，将增加 3,247.51 万元到 4,547.51 万元，同比增加 94.06%到 131.72%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 7,000 万元到 8,400 万元，与上年同期相比，将增加 3,032.32 万元到 4,432.32 万元，同比增加 76.43%到 111.71%。

2、预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 6,700 万元到 8,000 万元，与上年同期相比，将增加 3,247.51 万元到 4,547.51 万元，同比增加 94.06%到 131.72%。

（三）本期所预计的业绩情况未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）利润总额：4,321.95 万元。归属于母公司所有者的净利润：3,967.68 万元。
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：3,452.49 万元。

（二）每股收益：0.68 元。

三、本期业绩预增的主要原因

2025 年上半年，公司所在的半导体封装和测试设备领域需求回暖，同时公司持续进行技术研发和产品迭代，三温测试分选机及大平台超多工位测试分选机（针对效率要求更高的大规模、复杂测试）需求持续增长，公司测试分选机产品销量实现较大提升，公司 2025 年半年度业绩实现较好的增长。

四、风险提示

截至本公告日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2025 年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 15 日